

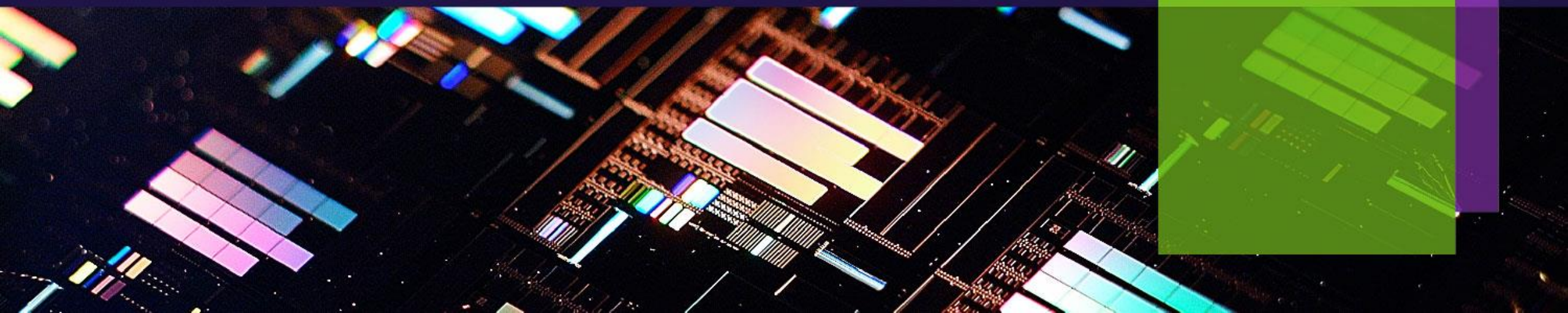


事業環境と業績予想

2016年5月12日

河合 利樹

代表取締役社長、CEO



事業環境

▶ 半導体設備投資

CY2016の半導体前工程（WFE*）の設備投資額は、前年同水準を見込む

- メモリ：DRAM向け投資は一巡、3D-NAND向け投資が拡大
- ファウンドリ/ロジック：年後半から先端ノード向け投資が立ち上がる

▶ FPD設備投資

CY2016のTFTアレイ工程**向けのFPD製造装置の需要は、モバイル用途の中小型パネル向け設備投資を中心に、前年比20%の増加を見込む

(2016年4月時点での見方)

不安定なマクロ経済の環境の中、 装置市場は技術革新の波に乗り、堅調な推移を想定

* WFE (Wafer Fab Equipment) : 半導体製造工程には、ウェハー状態で回路形成・検査をする前工程と、チップごとに切断・組立・検査をする後工程があります。
WFEは、前工程で使用される製造装置です。

** TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動させる側の基板を製造する工程

2017年3月期 業績予想

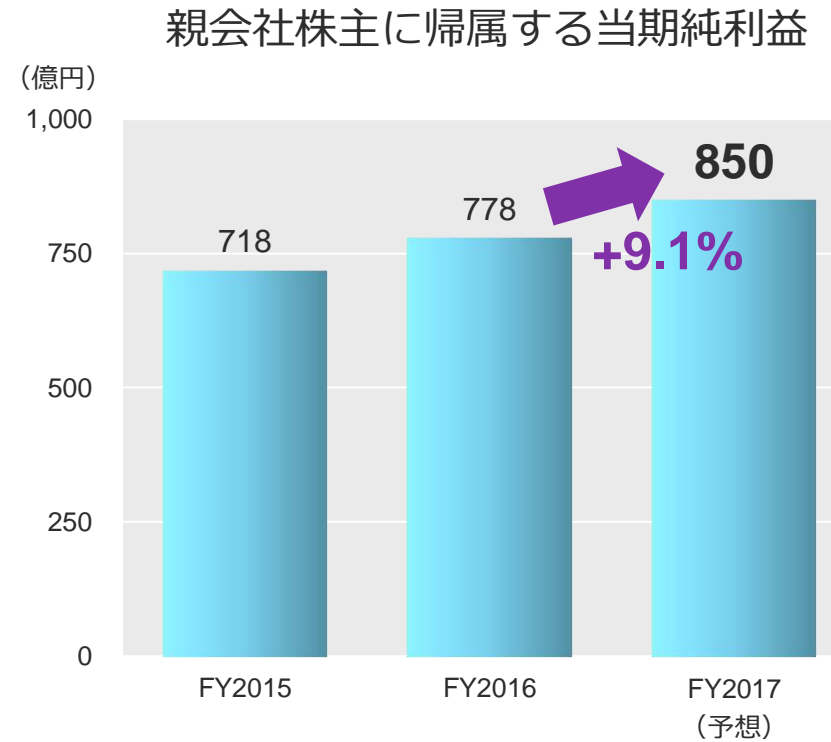
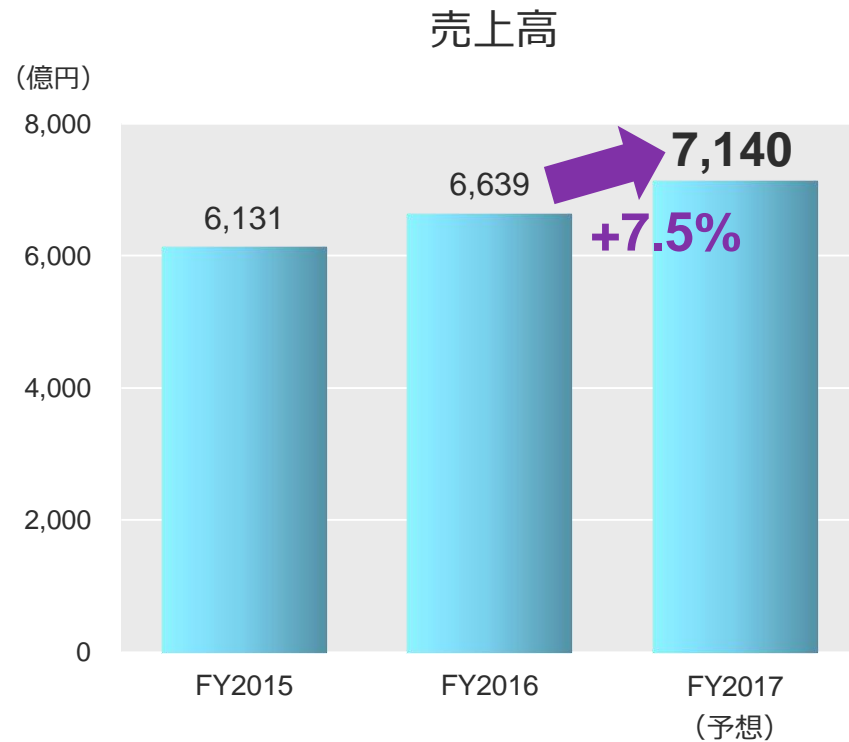
(億円)

	FY2016 (実績)	FY2017 (予想)			
		上期	下期	通期	対前年増減
売上高	6,639	3,300	3,840	7,140	+7.5%
SPE	6,130	3,040	3,610	6,650	+8.5%
FPD	446	260	230	490	+9.7%
営業利益	1,167	490	750	1,240	+73
下段：営業利益率	17.6%	14.8%	19.5%	17.4%	-0.2pts
特別損益	-129	-100	-	-100	+29
税前利益	1,064	390	750	1,140	+76
親会社株主に帰属する 当期純利益	778	290	560	850	+72
1株当たり当期純利益 (円)	461.10	176.79	341.39	518.18	+12.4%

SPE: 半導体製造装置、FPD: フラットパネルディスプレイ製造装置

前期に対し、さらなる増収増益を見込む

2017年3月期 業績予想



エッチング装置や洗浄装置が売上増を牽引

2017年3月期 業績予想について

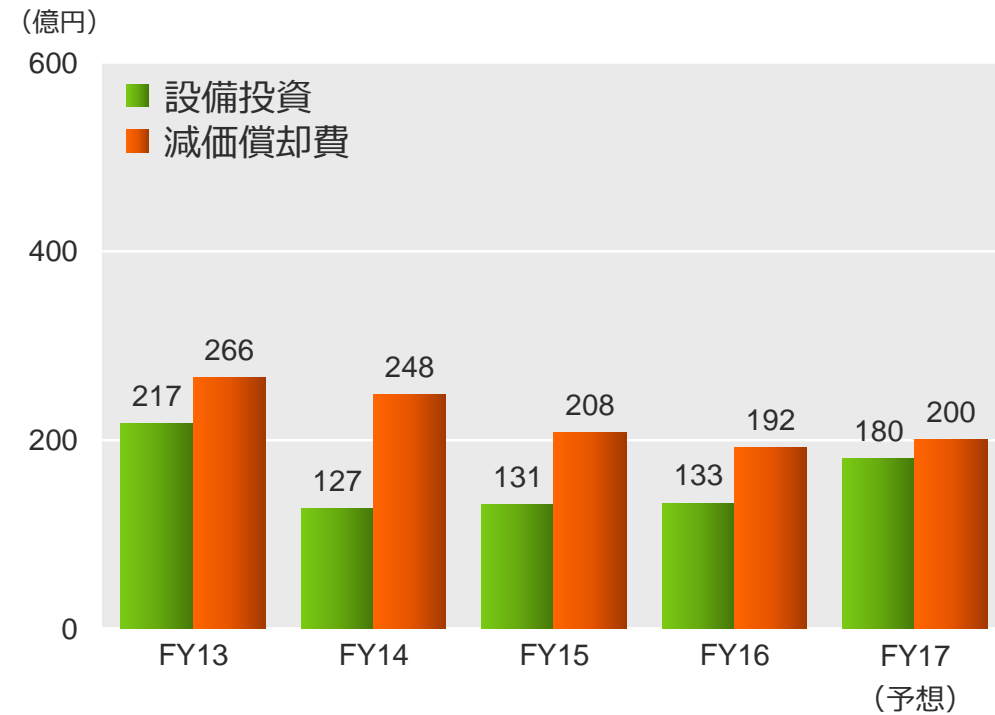
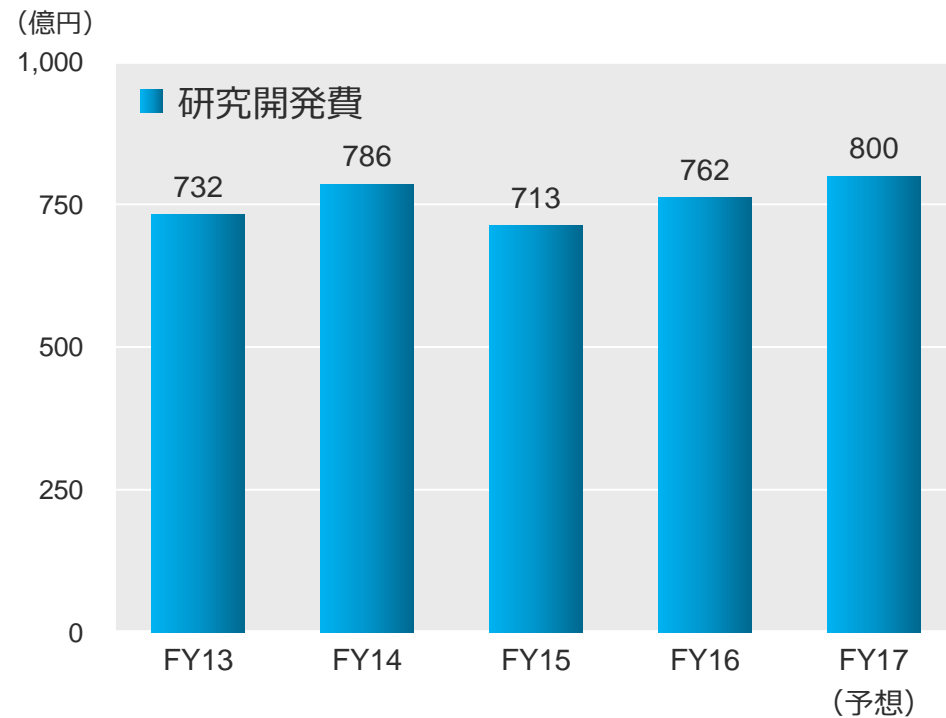
熊本地震の影響

- 生産・納入遅延による売上計上への影響なし
- 機械装置、在庫、建物等の復旧費用と各種支援、その他で概算100億円の特別損失の発生を上期に見込む

中期計画に向けた成長投資

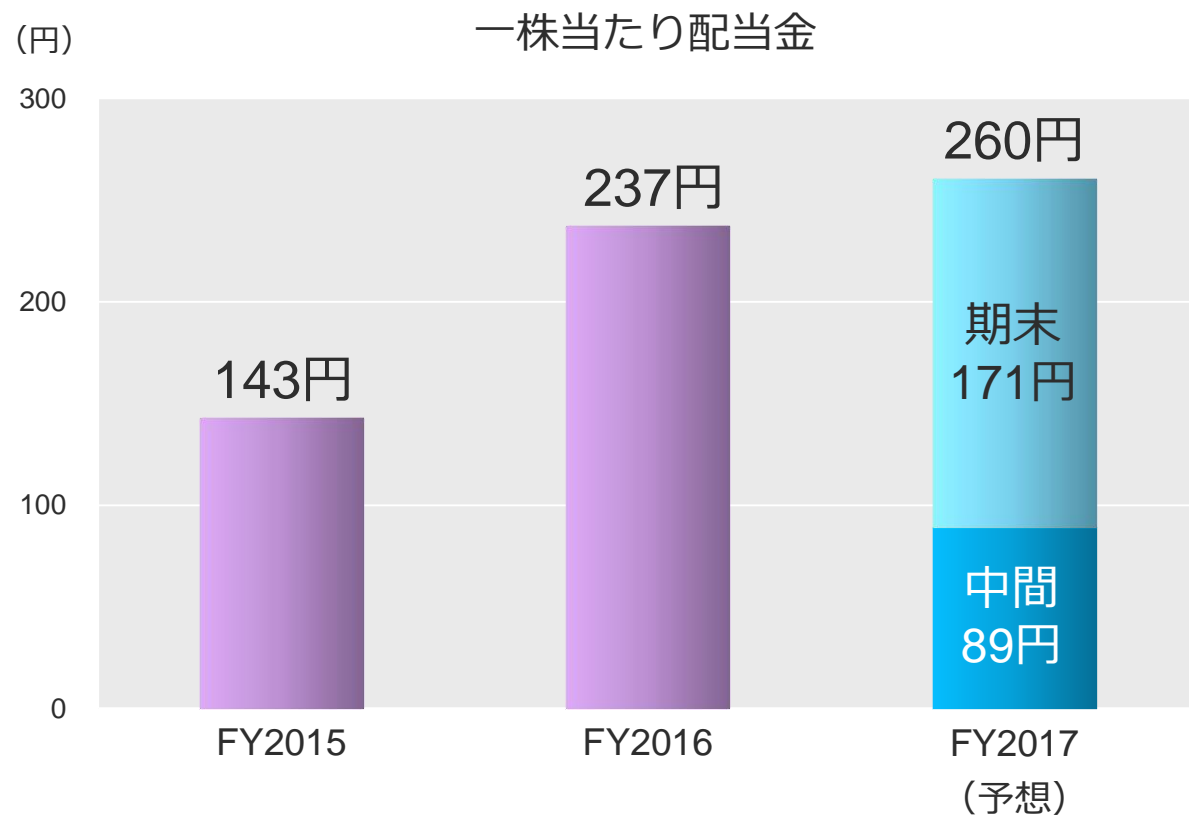
- 開発費 800億円：前期比+38億円
 - 注力分野（エッチング、成膜等）への投資増加
- 設備投資 180億円：前期比+47億円
 - 開発関連設備の増加

研究開発費・設備投資計画



成長分野への開発費および設備投資を増加

2017年3月期 配当予想



当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、一株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得： 機動的に実施を検討

一株当たり配当金は、3期連続で過去最高を更新予定

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ